(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年8月28日(28.08.2025)

WIPO | PCT

(10) 国際公開番号
WO 2025/177868 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) *C09J 7/25* (2018.01)
B32B 27/00 (2006.01) *H01L 21/301* (2006.01)

(21) 国際出願番号： PCT/JP2025/004242

(22) 国際出願日： 2025年2月7日(07.02.2025)

(25) 国際出願の言語： 日本語

(26) 国際公開の言語： 日本語

(30) 優先権データ：
特願 2024-025179 2024年2月22日(22.02.2024) JP

(71) 出願人: リンテック株式会社 (**LINTEC CORPORATION**) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３番２３号 (JP).

(72) 発明者: 長谷川 裕也 (**HASEGAWA Yuya**); 〒1730001 東京都板橋区本町２３番２３号 リンテック株式会社内 (JP). 山口 征太郎 (**YAMAGUCHI Seitaro**); 〒1730001 東京都板橋区本町２３番２３号 リンテック株式会社内 (JP).

(74) 代理人: 弁理士法人大谷特許事務所 (**OHTANI PATENT OFFICE**); 〒1050001 東京都港区虎ノ門三丁目２５番２号 虎ノ門ＥＳビル７階 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：
一 国際調査報告（条約第21条(3)）

WO 2025/177868 A1

(54) **Title:** ADHESIVE SHEET FOR WORKPIECE PROCESSING AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME, AND METHOD FOR MANUFACTURING ELECTRONIC DEVICE

(54) 発明の名称： ワーク加工用粘着シート及びその製造方法、並びに電子デバイス装置の製造方法

(57) **Abstract:** Provided are: an adhesive sheet for workpiece processing, the adhesive sheet having a buffer layer, a substrate, and an adhesive layer, wherein the buffer layer contains a cured product of a thermosetting resin composition; and a method for manufacturing an electronic device using said adhesive sheet for workpiece processing.

(57) 要約：緩衝層、基材及び粘着剤層を有し、前記緩衝層が、熱硬化性樹脂組成物の硬化物を含む層である、ワーク加工用粘着シート及び該ワーク加工用粘着シートを用いる電子デバイス装置の製造方法である。